

檔 號：

保存年限：

## 教育部 函

地址：10051臺北市中山南路5號

聯絡人：黃雅妮

電話：02-7736-6164

Email：evanell@mail.moe.gov.tw

受文者：國立中央大學

發文日期：中華民國107年6月4日

發文字號：臺教技(三)字第1070080254號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：無附件

主旨：函轉經濟部智慧財產局「2018台灣創新技術博覽會」發明競賽徵展訊息一案，請查照。

說明：

- 一、依據經濟部智慧財產局107年5月28日智國企字第10711005180號函辦理。
- 二、為彰顯台灣創新研發能量，並作為國際級研發交易樞紐平台，「台北國際發明暨技術交易展」自2018年起規劃轉型，展覽名稱變更為「台灣創新技術博覽會」（以下簡稱本展）。
- 三、本展去年展出近1,500項發明專利與創新技術，並邀請來自全球23個國家之發明人及廠商共襄盛舉，展期3天計吸引77,357人次買主及民眾前來觀展及尋找交易商機。
- 四、本年度將於107年9月27日至29日假台北世貿一館盛大展出，預計邀請20個以上國家、600家以上國內外發明人及廠商參展，並規劃分為「未來科技館」、「永續發展館」、「創新發明館」及「傑出發明館」等館。其中「創新發明館」由科技部、本部及國防部聯合辦理，將以學研單位研發成果作為展示主題，並由科技部另案於107年6月間統一向各學研機構辦理徵件。
- 五、另上開「傑出發明館」由經濟部智慧財產局主辦，將同步舉辦發明競賽，藉由競賽的肯定，促進得獎作品交易商機。報名期間自107年5月21日至6月30日止，展覽相關訊息、參展說明及報名表電子檔，可逕至專屬網站(<https://www.inventaipai.com.tw/>)查詢及下載使用；如有相關疑義，請逕洽經濟部智慧財產局王妍婷小姐，電話：(02)2376-6135。

裝

訂

線

正本：各公私立大專校院

副本：經濟部智慧財產局、經濟部工業局、科技部、本部高等教育司